



## 关于团体标准 T/CASAS 034—2024《用于零电压软开通电路的氮化镓高电子迁移率晶体管动态导通电阻测试方法》发布的通知

各成员单位：

按照 CASAS 相关管理办法，团体标准 T/CASAS 034—2024《用于零电压软开通电路的氮化镓高电子迁移率晶体管动态导通电阻测试方法》已遵照流程完成制定工作，现予以发布。

### **T/CASAS 034—2024《用于零电压软开通电路的氮化镓高电子迁移率晶体管动态导通电阻测试方法》**

#### **【本文件主要起草单位】**

浙江大学、浙江大学杭州国际科创中心、广东工业大学、工业和信息化部电子第五研究所、电子科技大学、南京大学、佛山市联动科技股份有限公司、佛山市国星光电股份有限公司、西交利物浦大学、香港科技大学、深圳智芯微电子科技有限公司、深圳市大能创智半导体有限公司、华为技术有限公司、苏州能讯高能半导体有限公司、英诺赛科(苏州)半导体有限公司、纳微达斯半导体(上海)有限公司、杭州士兰微电子股份有限公司、英飞凌科技(中国)有限公司、矽力杰半导体技术(杭州)有限公司、浙江聚新汽车电子有限责任公司、连云港杰瑞电子有限公司、晟星和科技(深圳)有限公司、杭州蔚斯博系统科技有限公司、深圳英飞源技术有限公司、深圳市航嘉驰源电气股份有限公司、东莞立讯技术有限公司、深圳市振华微电子有限公司、小米通讯技术有限公司、阳光电源股份有限公司、长城电源技术有限公司、北京第三代半导体产业技术创新战略联盟。

**【本文件主要起草人】**

吴新科、董泽政、贺致远、施宜军、明鑫、周峰、刘庆源、成年斌、刘雯、孙佳慧、文豪、谢斌、周泉斌、裴轶、田水林、刘小明、徐迎春、贾利芳、宋清亮、赵晨、徐昌国、王廷营、毛敏、刘钢、柳树渡、赵燕军、王福强、湛坤、林梓彦、王腾飞、蔡磊、赵璐冰。

特此通知。

北京第三代半导体产业技术创新战略联盟

2024年9月30日

